

平成 18 年 7 月 7 日

各 位

会社名 株式会社 ソ ディ ッ ク
代表者 代表取締役社長 塩 田 成 夫
(コード番号 6143 東証第二部)
問合せ先 取締役財務部部长 河 本 朋 英
電 話 0 4 5 - 9 4 2 - 3 1 1 1

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

平成 18 年 5 月 24 日開催の当社取締役会において決議いたしました第三者割当による募集株式の発行に関し、発行予定株式数の一部につき割当先より申込みを行う旨通知がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 第三者割当による募集株式の発行

(1) 発行新株式数	323,700 株 (発行予定株式数 850,000 株)
(2) 払込金額の総額	401,527,191 円 (1 株につき金 1,240.43 円)
(3) 増加資本金及び資本 準備金に関する事項	1 株につき 増加する資本金 621 円 1 株につき 増加する資本金 619.43 円
(4) 申込期間 (申込期日)	平成 18 年 7 月 14 日 (金)
(5) 払 込 期 日	平成 18 年 7 月 14 日 (金)

2. 今回の第三者割当増資による発行済株式総数の推移

現在の発行済株式総数	53,108,810 株 (平成 18 年 7 月 7 日現在)
第三者割当増資による増加株式数	323,700 株
第三者割当増資後の発行済株式総数	53,432,510 株

3. 新株式発行による資金の使途

今回の公募増資及び第三者割当増資に係る手取概算額上限 7,789 百万円について、5,000 百万円を本社ビルの増築を含む設備投資に、2,789 百万円を研究開発費にそれぞれ充当する予定であります。設備投資につきましては、5,000 百万円のうち、3,000 百万円を本社ビル増築 (ナノ加工技術開発設備を付設) の建設資金、残金を平成 19 年度及び平成 20 年度及び平成 21 年度の研究開発のための機械装置等の設備資金に充当する予定であります。研究開発費につきましては、新製品及び自社製開発 NC 装置等の平成 19 年度及び平成 20 年度及び平成 21 年度の開発資金に充当する予定であります。

以 上